

上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 8 月 30 日召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。
- 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）为增强公司 AIOT 芯片业务的边缘计算能力，以晶圆集成方式实现“感存算一体化”芯片的封测工艺，提升公司在智能声学、智能家居和可穿戴生物传感领域的关键技术水平，拟参与国家智能传感器创新中心（以下简称“国创中心”）的法人实体即上海芯物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“芯物科技”）的本轮增资。芯物科技本轮增资总金额为人民币 4.5 亿元，投前估值为人民币 2.37 亿元，每一元注册资本增资价格为人民币 2.2358 元。公司拟出资人民币 2,000.00 万元，认缴芯物科技新增的注册资本人民币 894.5148 万元，占本轮增资完成后芯物科技注册资本的 2.9112%。

经审议，董事会认为：目标公司成立于 2017 年 9 月 13 日，注册资本为人民

币 10,600.00 万元，是国创中心的法人实体。国创中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、MEMS 制造及封测工艺。目标公司以“公司+联盟”模式运行，致力于先进传感技术创新，联合传感器产业链上下游企业开展特色工艺研发，打造世界级智能传感器创新中心。

公司已于 2022 年与目标公司签订合作协议，在共建 AIOT 联合实验室的基础上，启动感存算一体化产业生态建设。双方规划通过 PZT 薄膜化 MEMS 生产工艺平台，感存算一体化芯片项目，充分发挥国创中心在 MEMS 传感器特色工艺、先进封测领域的技术优势和产业地位，利用润欣科技多年积累的供应商资源和产业布局，优势互补，在智能声学、智能家居、可穿戴生物传感等领域开展 IC 定制设计和产业合作。

本次投资，有利于双方进一步加深合作，拓展 MEMS Speaker、存算一体化芯片低温键合工艺、集成测试平台等新业务领域，为客户、股东创造更大的价值。

董事会一致同意公司与协议各方签署《上海芯物科技有限公司增资协议书》，并按照协议的约定如期缴付出资额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资的公告》(公告编号: 2023-047)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023年8月30日